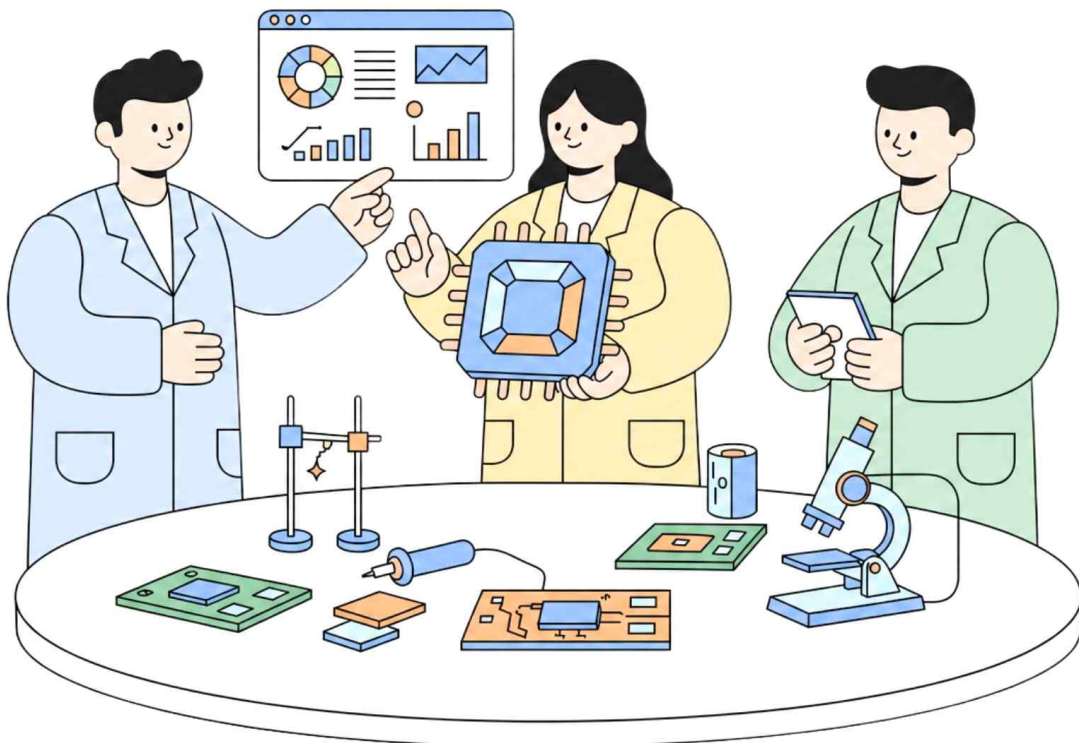


2026년 지능형 반도체 시험분석·성능검증 지원 (2차) 지원기업 모집 공고



『2026년 지능형 반도체 시험분석·성능검증 지원 (2차)』 모집 공고

경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원에서는 국내 팹리스 기업이 개발한 지능형 반도체 및 이를 적용한 제품의 시험분석·성능검증을 지원하여 기업의 기술개발 성과 확산을 도모하고자 하오니 기업의 많은 신청 바랍니다.

2026년 5월 15일

경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원장

1. 지원계획

1. 추진목적

- 국내 팹리스 기업이 개발한 지능형 반도체 및 이를 적용한 모듈, 보드, 제품의 시험분석·성능검증을 지원하여, 상용화 기반 마련과 글로벌 경쟁력 확보 지원

2. 지원개요

- 지원사업 : 2026년 지능형 반도체 시험분석·성능검증 지원
- 지원기간 : 2026년 7월 1일 ~ 11월 2일 (4개월)
- 지원범위 : 팹리스 기업이 개발한 지능형 반도체 및 이를 적용한 모듈, 보드, 제품의 시험분석 및 성능검증(인증)으로 기업에서 자율적으로 제시한 2개 이내의 제품
- 지원방식 : 직접(서비스)지원, 간접(비용)지원
 - * 직접(서비스)지원 : 지원기관의 시설, 장비, 인력 등 지원 인프라를 활용한 서비스 지원
 - * 간접(비용)지원 : 과제종료 후 지원기업과 계(확)약한 외부 용역/의뢰 기업에게 이용 비용 지급
- 지원한도 : 기업(과제)당 최대 1,000만원
 - * 부가가치세 제외
- 선정규모 : 10개 기업(과제) 내외
 - * 선정기업(과제) 수는 총 지원예산 범위 내에서 과제별 지원금액을 고려하여 결정

3. 지원내용

□ 지원항목 및 내용

- 과제별 지원한도 내에서 신청하되, 시험분석 서비스 지원은 필수 선택

지원항목	지원내용	지원방식	지원한도																									
시험분석 서비스	<p>- [필수] 기술원이 보유한 시험분석 장비와 전문인력을 통한 시험분석 지원</p> <p>※ 시험분석 서비스 가능 항목 예시</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>시험/검사 종류</th> <th>시험 장비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BGA 납땜 품질 검사</td> <td rowspan="5">스마트 센서 검사 시스템 (X-eye SF160ER)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SMD 부품 접합 검사</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>와이어 본딩 검사</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>다이 어태치/에폭시 분석</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>고밀도 PCB 내부 관찰</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>모듈/센서 패키지 내부 구조 파악</td> <td rowspan="5">전파시험(EMC) 장비</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>AXI 기반 자동 검사</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>EMI(전자파 간섭) 시험</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>EMS(전자파 내성) 시험</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ESD(정전기 방전) 시험</td> </tr> </tbody> </table>	No.	시험/검사 종류	시험 장비	1	BGA 납땜 품질 검사	스마트 센서 검사 시스템 (X-eye SF160ER)	2	SMD 부품 접합 검사	3	와이어 본딩 검사	4	다이 어태치/에폭시 분석	5	고밀도 PCB 내부 관찰	6	모듈/센서 패키지 내부 구조 파악	전파시험(EMC) 장비	7	AXI 기반 자동 검사	8	EMI(전자파 간섭) 시험	9	EMS(전자파 내성) 시험	10	ESD(정전기 방전) 시험	직접지원 (서비스)	무상
No.	시험/검사 종류	시험 장비																										
1	BGA 납땜 품질 검사	스마트 센서 검사 시스템 (X-eye SF160ER)																										
2	SMD 부품 접합 검사																											
3	와이어 본딩 검사																											
4	다이 어태치/에폭시 분석																											
5	고밀도 PCB 내부 관찰																											
6	모듈/센서 패키지 내부 구조 파악	전파시험(EMC) 장비																										
7	AXI 기반 자동 검사																											
8	EMI(전자파 간섭) 시험																											
9	EMS(전자파 내성) 시험																											
10	ESD(정전기 방전) 시험																											
시험분석 성능검증	<p>- 팹리스 기업이 개발한 지능형 반도체 및 모듈, 보드, 제품의 시험분석 및 성능검증(인증) 지원</p>	간접지원 (비용)	최대 10,000 천원																									

4. 신청자격

□ 지원대상

- 비수도권 (서울, 경기, 해외 제외) 내 본사, 지사, 연구소 중 1개 이상 소재하고 있는 **국내 팹리스 전문 중소기업¹⁾ 및 중견기업²⁾**
- 비수도권 소재 팹리스 중소·중견기업과 수요기업의 컨소시엄*
 - * 컨소시엄으로 신청하는 경우에도 지원 방식 및 한도는 동일하며 신청 주체는 팹리스 중소·중견기업이어야 함

□ 지원제외 대상

- 지원받고자 하는 제품이 타 정부·지직접·기관에서 동일 지원항목의 지원을 받았거나, 지원을 받고 있는 경우 (중복 지원에 해당)
- 접수마감일 현재, 대표자와 책임자가 참여제한 등의 제재를 받고 있는 경우
- 세무당국에 의하여 국세, 지방세 등의 체납처분을 받은 경우
- 신청일 현재 휴업 또는 폐업된 경우
- 최근 2년 연속 결산 재무제표상 부채비율이 500% 이상 또는 유동비율이 50% 이하인 기업 및 최근년도 결산 기준 자본 전액 잠식 상태에 있는 경우 (설립 후 7년 미경과 기업은 적용하지 않음)
 - * 설립일은 사업자등록증 상 개업년월일을 기준으로 함
- 지원제외 대상 여부는 동일한 조건을 기준으로 선정평가위원회에서 최종 판단

□ 우대사항

우대조건	가점
• 지능형반도체개발지원센터 입주기업 - 제출서류 : 없음 (별도 확인)	5점

1) 중소기업기본법 제2조 및 중소기업법시행령 제3조 (중소기업의 범위) 참조

2) 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조 참조

II. 접수 및 평가

1. 지원신청서 접수

□ 공모 및 접수기간 : 2026년 5월 15일 ~ 6월 12일 (28일간)

□ 지원신청

• 접수방법 : 제출서류를 모두 구비하여 이메일 (cisdaegu@iact.or.kr) 제출

* 마감일 16시 이전 도착분에 한하며, 제출 후 필히 '접수 확인 메일' 확인 (접수 후 1시간 이내 확인 메일 미수신시 미접수 상태이므로 접수 여부 유선 문의)

• 제출서류

순번	구분	제출서류	수량	유형	비고
1	필수	지원신청서	1부	*.hwp	지정서식
2		참여제한정보 검색결과 (별첨 1. 참조)	1부	스캔본 (*pdf)	책임자
3		사업자등록증	1부		
4		최근 2개년도 기업 재무제표	1부		
5		국세 및 지방세 완납 증명서	1부		
6		지원금 산출 근거 (견적서 등)	각 1부		
7	선택	기타 추가 증빙서류			

* 사본은 원본대조필 날인 필수

• 서류제출 시 유의사항

- 제출서류

㉠ 제출서류는 반드시 첨부된 지정서식을 사용하여야 하며, 누락되는 일이 없도록 제출 이전 필히 점검 (지정서식 이외 서식 사용, 서식 임의 변경, 제출서류 누락의 경우 선정평가 대상에서 제외)

㉡ 신청서의 성실한 작성도 평가항목이므로 예시 및 작성요령에서 제시한 사항 (파란글씨)을 참고하여 성의있게 작성

㉢ 제출서류가 위·변조 혹은 허위임이 밝혀질 경우 그 즉시 선정 취소 또는 협약이 해약되므로 사실대로 작성하여 제출할 것

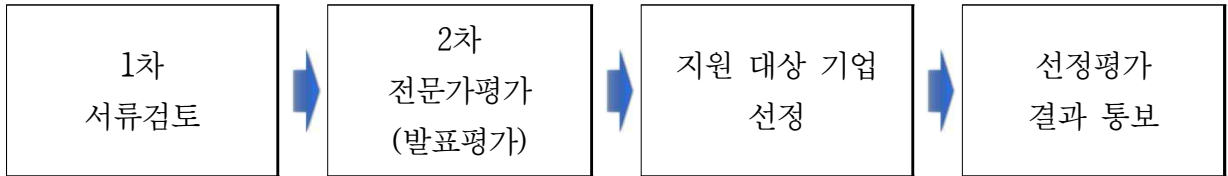
㉣ '기타 추가 증빙서류' (7번) 는 본 과제와 관련하여 추가로 제출하고자 하는 서류가 있을 경우만 제출 (ex. 소재지 증명, 관련 특허증, 수상이력 등)

㉤ 서류제출 시 파일명에 순번과 서류명, 신청기업명 기입 (ex. 3_사업자등록증 ((주)침정원).pdf)

2. 선정평가

□ 평가절차

- 지능형반도체개발지원센터 직접 1차 서류검토 이후 각 분야별 전문가로 구성된 선정평가위원회의 2차 전문가평가를 거쳐 신규 지원 대상 기업 선정



* 필요한 경우 평가절차를 변경하거나 추가할 수 있으며 평가시간 및 결과는 개별 통보

□ 평가기준

- **(1차 서류검토)** 제출된 서류로 신청기업의 적합성 여부 판단

평가항목	평가내용	평가지표
신청자격 적합성	신청서류 적합성*	신청서의 오류 및 성실작성 여부 제출서류의 누락 및 부실 여부
	신청자격 적합성	지원 및 제외 대상 해당 여부

* 작성 요청사항과의 부합·구체적 기술 정도 등을 고려하여 누락 및 부실 (2차 전문가평가의 평가지표에 따른 평가가 불가할 정도) 작성 여부 정성적 판단

- **(2차 전문가평가)** 발표평가를 통해 과제수행 타당성, 수행계획 우수성, 성과창출 가능성을 종합적으로 평가하여 신규 지원 대상 기업 선정

평가항목	평가내용	평가지표
과제수행 타당성	수행역량 및 지원 필요성	신청기업의 보유 핵심역량 (기술력, 마케팅 등)
		지원의 합리적 필요정도
수행계획 우수성	제품 우수성	제품의 기능적 효용성 및 혁신성
		제품의 사업성 (시장규모, 수익구조 등)
성과창출 가능성	수행계획 적절성	시험분석 및 성능검증 계획의 명확성 및 구체성
	사업비 사용 계획	사업비 편성 및 산출의 적절성
성과창출 가능성	성공적인 추진 가능성	설정 성과목표의 현실성 및 달성 가능성
		신청기업의 추진의지

□ 선정평가 결과 발표

- 선정평가 결과는 지원신청서에 기재된 담당자의 연락처와 e-mail을 통해 개별 통보하며, 평가결과는 원칙적으로 공개하지 않음

공모 및 신청 문의

- 담당자 : 김태연 연구원
- 연락처
 - 전 화 : 053-219-0343 (10:00~17:00)
 - 이 메 일 : cisdaegu@iact.or.kr

별첨 1. 제재정보 조회 방법

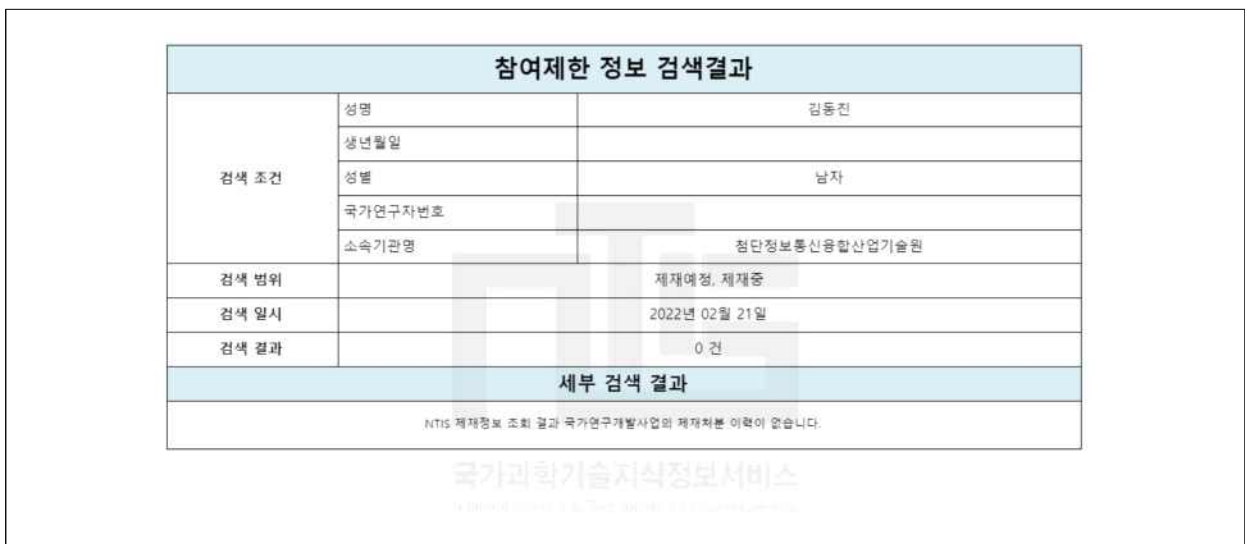
- ① 국가R&D사업관리서비스(https://www.ntis.go.kr) 회원가입 또는 로그인 (개인별)
- ② ‘과제참여·관리-제재정보조회’ 에서 대표자 및 책임자의 제재정보 조회



- ③ 조회결과페이지 출력 (소속기관명과 신청기업이 일치해 함)



<제재정보 조회페이지>



<제출 결과물>